公司代码:688012　　公司简称:中微公司

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中微公司	688012	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	刘方	胡潜
电话	021-61001199	021-61001199
办公地址	上海市浦东新区金桥综合保税区泰华路188号	上海市浦东新区金桥综合保税区泰华路188号
电子信箱	IR@amcomsh.com	IR@amcomsh.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	37,736,913,182.75	29,846,018,981.43	26.44
归属于上市公司股东的净资产	30,037,754,322.85	22,694,616,797.16	32.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,691,287,327.67	4,960,601,276.04	34.89
利润总额	2,078,616,147.29	717,766,508.36	301.06
归属于上市公司股东的净利润	2,025,194,624.91	705,916,536.34	300.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,122,560,338.26	538,767,846.46	108.36
经营活动产生的现金流量净额	684,563,490.60	202,896,547.30	237.29
加权平均净资产收益率(%)	11.56	3.49	增加8.07个百分点
基本每股收益(元/股)	4.33	1.13	283.19
稀释每股收益(元/股)	4.33	1.12	286.61
研发投入占营业收入的比例(%)	30.51	30.07	增加0.44个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	89,848
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	–

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海创业投资有限公司	国有法人	13.64	129,960,899	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	13.23	126,046,718	0	0	无	0
寰鑫(上海)投资有限公司	国有法人	8.26	78,717,005	0	0	无	0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期投份有限公司	国有法人	2.97	28,314,016	0	0	无	0
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.49	14,236,111	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.25	11,895,379	0	0	无	0
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19	11,312,565	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78	7,402,327	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金	其他	0.72	6,840,031	0	0	无	0
尹志尧	境内自然人	0.63	5,998,877	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	寰鑫(上海)投资有限公司与华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期投份有限公司存在关联关系。除此之外,未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688012　　证券简称:中微公司　　公告编号:2026-078

中微半导体设备(上海)股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次增加的关联交易属于公司日常关联交易,是正常生产经营业务,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于增加预计2026年度日常关联交易的议案》,本次增加日常关联交易预计金额合计为20,000万元人民币,涉及向关联人销售商品及提供劳务。关联董事袁训旺回避了表决,此议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

2026年8月19日,公司召开独立董事2026年第三次专门会议,审议通过《关于增加预计2026年度日常关联交易的议案》,此议案获全体独立董事一致表决通过。

本次增加日常关联交易事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币　万元

关联交易类别	关联人	2026年度已预计的交易金额	本次新增预计金额	本次新增后2026年度预计交易总金额	本次新增后截止企业账户同类业务比例	本年年初至2026年6月30日与关联人累计已发生的交易金额	本次新增的原因
向关联人销售商品及提供劳务	客户2和和客户3	90,000	20,000	110,000	8.88%	48,979	公司完成交付收购,新增关联交易金额
	小计	90,000	20,000	110,000	8.88%	48,979	

注1:上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2025年同类业务金额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币　万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额(2026年全年预计金额)	本年年初至2026年6月30日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品,提供劳务和出租房屋	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	10,000	4,360	
	客户1	10,000	1,863	客户采购计划调整
	客户2和客户3	90,000	48,979	
	小计	110,000	55,202	
向关联人采购商品、设备、接受劳务和承租房屋	睿励科学仪器(上海)有限公司	3,000	173	公司业务计划调整
	上海智微私募基金管理有限公司及其控制的主体	300	0	
	供应商1	5,005	35	公司业务计划调整
	小计	8,305	208	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

客户2、客户3:根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,本次交易对方客户2、客户3与公司构成关联关系,为公司关联法人,上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密,披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响,损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定,履行了信息豁免披露内部登记及审批程序,为维护上市公司及投资者利益,公司对本次关联交易的关联方基本情况进行了豁免脱敏。

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	客户2和客户3	董事袁训旺任董事的公司

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、新增日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方销售商品及提供劳务,主要包括销售刻蚀设备、MOCVD设备、薄膜沉积设备及相应的备品备件、提供劳务等。关联销售价格主要根据客户在规格型号、产品标准、技术参数等方面的要求,依据市场公允价格确定,不同客户的产品在性能、结构等方面不同,销售价格会存在一定的差异。

(二)关联交易协议签署情况

为维护双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、新增日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易主要为向关联方销售商品及提供劳务,主要包括销售刻蚀设备、MOCVD设备、薄膜沉积设备及相应的备品备件、提供劳务等,关联销售价格主要根据客户在规格型号、产品标准、技术参数等方面的要求,依据市场公允价格确定,不同客户的产品在性能、结构等方面不同,销售价格会存在一定的差异。

(一)关联交易协议签署情况

为维护双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、新增日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易;上述新增关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述新增关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:688012　　证券简称:中微公司　　公告编号:2026-081

中微半导体设备(上海)股份有限公司
关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“ 公司 ”)于2026年8月19日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向控股子公司众硅电子科技(上海)有限公司(以下简称“上海众硅 ”)提供不超过73,041.47万元的借款,用以实施“高端半导体设备产化项目”及“高端半导体设备研发中心项目”。独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)发表了核查意见。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2026]1147号),同意公司向不超过35名特定投资者发行股份不超过6,300,932股(含本数,以下简称“本次发行 ”)的注册申请。公司向4名特定投资者发行人民币普通股(A股)5,156,765股,每股发行价为人民币290.88元,募集资金总额为人民币1,499,999,803.20元,扣除本次发行费用人民币10,118,562.20元,实际募集资金净额为人民币1,489,881,241.00元。上述资金到位情况已经由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2026)第0016号)。

二、募集资金投资项目情况

公司于2026年8月19日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了 《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》,根据披露的募集资金使用计划以及实际收到的募集资金净额,结合募投项目的实际情况,公司募投项目拟使用募集资金金额具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	占募集配套资金比例
1	高端半导体设备产业化项目	38,338.89	25.56%
2	高端半导体设备研发中心项目	34,702.57	23.14%
3	支付现金对价及中介机构费用	6,958.53	4.64%
4	补充流动资金	70,000.00	46.67%
合计		150,000.00	100.00%

三、本次使用募集资金向子公司提供借款的情况

公司募投项目(高端半导体设备产业化项目、高端半导体设备研发中心项目)的实施主体为控股子公司上海众硅,公司拟向其提供不超过73,041.47万元的借款用于上述项目实施。公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求,一次或分次逐步向子公司提供借款。借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。借款利息按照借款实际发放之日起算,借款利率将参考同期市场利率,由双方协商确定。

本次公司提供的借款将存放于子公司开立的募集资金存储专用账户进行管理,专项用于募投项目的实施,不得用作其他用途。董事会授权公司管理层全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。

四、借款对象的基本情况

1、基本情况

公司名称	众硅电子科技(上海)有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	CIU HAIYANG
注册资本	500万元
成立日期	2022-02-14
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼
经营范围	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;机械设备研发;电子专用设备销售;半导体器件专用设备销售;电子产品销售;机械设备销售;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年度/2025.12.31	102,212.66	75,280.39	24,411.88	-9,250.00

五、本次提供借款对公司的影响及风险防范措施

公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款,是基于募集资金投资项目实施需要,有利于保障募集资金投资项目顺利实施,符合募集资金使用计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

上海众硅是公司的控股子公司,公司具备提供借款期间对其生产经营活动有控制权,财务风险可控。公司将加强对上海众硅的经营管理的监督,控制资金风险保障资金安全。

六、本次提供借款后募集资金的使用和管理

为确保募集资金使用安全,公司和上海众硅已与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署募集资金专户存储监管协议对募集资金进行监管。公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,规范使用募集资金,并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

七、履行的审议程序

公司于2026年8月19日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向控股子公司上海众硅提供不超过73,041.47万元的借款,用以实施高端半导体设备产业化项目与高端半导体设备研发中心项目。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

八、专项意见说明

经核查,独立财务顾问认为:公司本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项主要是基于募投项目的建设需要,有助于满足募投项目资金需求,提高募集资金使用效率,保障募投项目顺利实施,符合募集资金实施计划,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

经上所述,独立财务顾问对公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:688012　　证券简称:中微公司　　公告编号:2026-077

中微半导体设备(上海)股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2026年半年度(以下简称“报告期”或“本报告期”)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

1.2019年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日签发的证监许可[2019]1168号文《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,中微半导体设备(上海)股份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股53,486,224股,每股发行价格为人民币29.01元,股款以人民币缴足,计人民币155,163,547.24元,扣除承销及保荐费用共计人民币8,782,84万元后,实际收到募集资金计人民币146,380,69万元,再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计1,810.41万元后,实际募集资金净额为人民币144,570.28万元(以下简称“首发募集资金”),上述资金于2019年7月16日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2019)第0411号验资报告。

2.2020年度向特定对象发行A股股票募集资金

中国证券监督管理委员会于2021年3月3日出具证监许可[2021]645号文《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准了公司向特定对象发行80,229,335股人民币普通股A股股票,截至2021年6月22日止,公司完成了人民币普通股A股80,229,335股的发行,每股发行价格为人民币102.29元,股款以人民币缴足,合计人民币820,665.87万元,扣除承销及保荐费用共计人民币8,206.66万元(不含增值税)后,实际收到募集资金计人民币812,459.21万元,再扣除其他发行费用人民币合计642.96万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币811,816.24万元(以下简称“再融资募集资金”),上述资金于2021年6月22日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2021)第0638号验资报告。

3.发行股份购买资产并募集配套资金

中国证券监督管理委员会于2026年5月11日出具证监许可[2026]1147号文《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准了公司向特定对象发行5,156,765股人民币普通股A股股票。截至2026年6月17日止,公司完成了人民币普通股A股5,156,765股的发行,每股发行价格为人民币290.88元,股款以人民币缴足,合计人民币149,999.98万元,扣除承销及保荐费用共计人民币954.00万元(不含增值税)后,实际收到募集资金计人民币149,045.98万元,再扣除其他发行费用人民币合计57.86万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币148,988.12万元(以下简称“配套募集资金”),上述资金于2026年6月17日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2026)第0016号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2019年7月16日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	156,163.54
其中:超募资金金额	44,570.28
减:直接支付发行费用	10,593.26
二、募集资金净额	144,570.28
减:	
以前年度已使用金额	130,061.20
本年度使用金额	–
暂时补流金额	–
现金管理金额	18,991.95
银行手续费支出及汇兑损益	0.58
募投项目结项资金转出	4,425.06
增值税税金	620.00
加:	
募集资金利息收入	9,548.75
其他	
三、报告期末募集资金余额	20.24

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间	2021年6月22日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	820,665.87
其中:超募资金金额	–
减:直接支付发行费用	8,849.63
二、募集资金净额	811,816.24
减:	
以前年度已使用金额	680,793.15
本年度使用金额	27,932.71
暂时补流金额	–
现金管理金额	148,336.90
银行手续费支出及汇兑损益	1.64
加:	
募集资金利息收入	46,736.82
其他	422.28
三、报告期末募集资金余额	910.94

单位:万元　币种:人民币

发行名称	发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2026年6月17日
本次报告期	2026年6月17日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	149,999.98
其中:超募资金金额	–
减:直接支付发行费用	1,011.86
二、募集资金净额	148,988.12
减:	
以前年度已使用金额	–
本年度使用金额	96400
暂时补流金额	–
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	–
加:	
募集资金利息收入	–
其他	1,011.86
三、报告期末募集资金余额	149,045.98

二、募集资金管理情况

中微公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《中微公司:募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股票			
募集资金到账时间	2019年7月16日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国建设银行上海金桥支行	31050161373600004844	20.24	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	招商银行上海金桥支行	121910890310602	–	已注销
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中信银行上海浦东分行	8110201014101024127	–	已注销

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票			
募集资金到账时间	2021年6月22日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中微半导体设备(上海)股份有限公司	招商银行上海分行	121910890310707	80.13	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中信银行上海浦东分行	8110201013601303837	143.58	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801900002862	633.82	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国建设银行上海金桥支行	31050161373600006133	53.40	使用中

单位:万元　币种:人民币

发行名称	发行股份购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间	2026年6月17日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中微半导体设备(上海)股份有限公司	国家开发银行上海分行	31000109000000100378	38,338.89	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050161364000011938	76,004.51	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	平安银行上海分行营业部	15001217560061	34,702.57	使用中

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司作为实施主体在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。本报告期公司募投项目先期投入及置换情况见下表:

募集资金置换先期投入表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票					
募集资金到账时间	2021年6月22日					
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期	
中微产业化基地建设项目	317,000.00	–	–	不适用	2025年8月28日	
中微临港总部和研发中心项目	375,000.00	10,999.13	10,999.13	2026年	2025年8月28日	
科技储备资金	119,816.24	–	–	不适用	2025年8月28日	

单位:万元　币种:人民币

发行名称	发行股份购买资产并募集配套资金					
募集资金到账时间	2026年6月17日					
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期	
高端半导体设备产业化项目	38,338.89	–	–	不适用	2026年8月19日	
高端半导体设备研发中心项目	34,702.57	–	–	不适用	2026年8月19日	
支付现金对价及中介机构费用	6,958.53	6,00451	–	不适用	2026年8月19日	
补充流动资金	70,000.00	–	–	不适用	2026年8月19日	

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金通过通知存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月。

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过180,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,在不超过上述额度及有效期内,可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
180,000	安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品	2026年4月28日	2027年4月27日	2026年3月30日

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股票							
募集资金到账时间	2019年7月16日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	已还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中微半导体设备(上海)股份有限公司	上海银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	18,000.00	11/11/2025	2/9/2026	2/9/2026	0.00	1.65%	77.07
中微半导体设备(上海)股份有限公司	上海银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	18,000.00	3/12/2026	6/10/2026	6/10/2026	0.00	1.65%	73.23
中微半导体设备(上海)股份有限公司	上海银行股份有限公司上海分行	协定存款	协定存款	18,991.95	7/16/2025	7/15/2026	不适用	18,991.95	0.53%	13.40

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票							
募集资金到账时间	2021年6月22日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	已还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中微半导体设备(上海)股份有限公司	国家开发银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	七天通知存款	16,949.47	无固定期限	无固定期限	不适用	16,949.47	1.55%	529.91
中微半导体设备(上海)股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	24,363.75	无固定期限	无固定期限	不适用	24,363.75	1.95%	
南昌中微半导体设备有限公司	招商银行股份有限公司南昌高新支行	协定存款	协定存款	361.51	无固定期限	无固定期限	不适用	361.51	1.50%	0.20
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	七天通知存款	4,000.00	无固定期限	无固定期限	不适用	4,000.00	1.35%	
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	协定存款	协定存款	1,997.01	无固定期限	无固定期限	不适用	1,997.01	0.35%	3.36
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国进出口银行上海分行	协定存款	协定存款	353.48	无固定期限	无固定期限	不适用	353.48	0.45%	0.70
中微半导体设备(上海)股份有限公司	国家开发银行股份有限公司上海市分行	协定存款	协定存款	1,801.13	无固定期限	无固定期限	不适用	1,801.13	0.45%	3.35
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海长宁区分行	协定存款	协定存款	21,188.63	无固定期限	无固定期限	不适用	21,188.63	0.35%	39.64
中微半导体设备(上海)股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行营业部	协定存款	协定存款	16,554.38	无固定期限	无固定期限	不适用	16,554.38	0.45%	37.81
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	协定存款	协定存款	1,347.46	无固定期限	无固定期限	不适用	1,347.46	0.45%	0.34
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	协定存款	协定存款	10,419.83	无固定期限	无固定期限	不适用	10,419.83	0.35%	18.41
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海嘉昌支行	协定存款	协定存款	3,618.16	无固定期限	无固定期限	不适用	3,618.16	0.45%	8.27
中微半导体设备(上海)股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	协定存款	协定存款	143.67	无固定期限	无固定期限	不适用	143.67	0.45%	0.23
中微半导体设备(上海)股份有限公司	上海银行股份有限公司闵行区支行	协定存款	协定存款	238.45	无固定期限	无固定期限	不适用	238.45	0.53%	0.52
中微半导体设备(上海)股份有限公司	光大银行隆昌支行	七天通知存款	七天通知存款	7,000.00	无固定期限	无固定期限	不适用	7,000.00	0.75%	
中微半导体设备(上海)股份有限公司	光大银行隆昌支行	结构性存款	结构性存款	8,000.00	12/31/2025	3/31/2026	3/31/2026		1.65%	33.00
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	结构性存款	20,000.00	1/1/2026	1/30/2026	1/30/2026		1.70%	27.01
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	结构性存款	20,000.00	2/1/2026	2/28/2026	2/28/2026		1.70%	25.15
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	3/1/2026	3/31/2026	3/31/2026		1.62%	14.14
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	3/1/2026	5/29/2026	5/29/2026		1.60%	41.45
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	4/1/2026	4/30/2026	4/30/2026		1.70%	13.51
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	5/1/2026	5/29/2026	5/29/2026		1.65%	12.66
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	结构性存款	20,000.00	6/3/2026	9/3/2026	不适用	20,000.00	1.65%	
中微半导体设备(上海)股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	1/6/2026	1/30/2026	1/30/2026		1.54%	10.13
中微半导体设备(上海)股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2/2/2026